

2024-2030年中国半导体材料行业市场现状调查及 投资前景研判报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2024-2030年中国半导体材料行业市场现状调查及投资前景研判报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1171445.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2024-2030年中国半导体材料行业市场现状调查及投资前景研判报告》共七章。首先介绍了半导体材料行业市场发展环境、半导体材料整体运行态势等，接着分析了半导体材料行业市场运行的现状，然后介绍了半导体材料市场竞争格局。随后，报告对半导体材料做了重点企业经营状况分析，最后分析了半导体材料行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体材料产业有个系统的了解或者想投资半导体材料行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章 半导体材料行业概念界定及发展环境剖析

1.1 半导体材料的概念界定及统计口径说明

1.1.1 半导体材料概念界定

1.1.2 半导体材料的分类

(1) 前端制造材料

(2) 后端封装材料

1.1.3 行业所属的国民经济分类

1.1.4 本报告的数据来源及统计标准说明

1.2 半导体材料行业政策环境分析

1.2.1 行业监管体系及机构

1.2.2 行业规范标准

1.2.3 行业发展相关政策汇总及重点政策解读

(1) 行业发展相关政策汇总

(2) 行业发展重点政策解读

1.2.4 行业相关规划汇总及解读

(1) 国家层面

(2) 地方层面

1.2.5 政策环境对行业发展的影响分析

1.3 半导体材料行业经济环境分析

1.3.1 宏观经济现状

- (1) GDP发展分析
- (2) 固定资产投资分析
- (3) 工业经济运行分析
- 1.3.2 经济转型升级发展分析（智能制造）
- 1.3.3 宏观经济展望
 - (1) GDP增速预测
 - (2) 行业综合展望
- 1.3.4 经济环境对行业发展的影响分析
- 1.4 半导体材料行业投资环境分析
 - 1.4.1 国家集成电路产业投资基金
 - (1) 大基金一期
 - (2) 大基金二期
 - 1.4.2 半导体材料行业投资、兼并与重组分析
 - (1) 行业投资、兼并与重组发展现状分析
 - (2) 行业投资、兼并与重组发展事件汇总
 - 1.4.3 投资环境对行业发展的影响分析
- 1.5 半导体材料行业技术环境分析
 - 1.5.1 半导体行业技术迭代
 - 1.5.2 相关专利的申请情况分析
 - (1) 硅片
 - (2) 电子特气
 - (3) 光刻胶
 - 1.5.3 美国对中国半导体行业的相关制裁事件
 - 1.5.4 半导体材料行业技术发展趋势
 - 1.5.5 技术环境对行业发展的影响分析

第2章 全球及中国半导体行业发展及半导体材料所处位置

- 2.1 半导体产业迁移历程分析
 - 2.1.1 全球半导体产业迁移路径总览
 - 2.1.2 阶段一：从美国向日本迁移
 - 2.1.3 阶段二：向韩国、中国台湾迁移
 - 2.1.4 阶段三：向中国大陆地区转移
 - 2.1.5 全球半导体产业发展总结分析
- 2.2 全球半导体行业发展现状分析
 - 2.2.1 全球半导体行业市场规模

- 2.2.2 全球半导体行业结构竞争格局
- 2.2.3 全球半导体行业产品竞争格局
- 2.2.4 全球半导体行业区域竞争格局
- 2.3 中国半导体行业发展现状分析
 - 2.3.1 中国半导体行业市场规模
 - 2.3.2 中国半导体行业结构竞争格局
 - (1) 中国半导体行业结构竞争格局
 - (2) 半导体设计环节规模
 - (3) 半导体制造环节规模
 - (4) 半导体封装测试环节规模
 - 2.3.3 中国半导体行业区域竞争格局
- 2.4 半导体材料与半导体行业的关联
 - 2.4.1 半导体材料在半导体产业链中的位置
 - 2.4.2 半导体材料对半导体行业发展的影响分析
- 2.5 全球及中国半导体行业发展前景及趋势分析
 - 2.5.1 半导体行业发展前景分析
 - (1) 全球半导体行业发展前景分析
 - (2) 中国半导体行业发展前景分析
 - 2.5.2 半导体行业发展趋势分析

第3章 全球半导体材料行业发展现状及前景分析

- 3.1 全球半导体材料行业发展现状分析
 - 3.1.1 全球半导体材料行业发展历程
 - 3.1.2 全球半导体材料行业市场规模
 - 3.1.3 全球半导体材料行业竞争格局
 - (1) 区域竞争格局
 - (2) 产品竞争格局
 - (3) 企业/品牌竞争格局
- 3.2 全球主要国家/地区半导体材料行业发展现状分析
 - 3.2.1 中国台湾地区半导体材料行业发展分析
 - (1) 半导体材料行业发展特点
 - (2) 半导体材料行业市场规模
 - (3) 半导体材料行业在全球的地位
 - 3.2.2 韩国半导体材料行业发展分析
 - (1) 半导体材料行业发展特点

- (2) 半导体材料行业市场规模
- (3) 半导体材料行业在全球的地位
- 3.2.3 日本半导体材料行业发展分析
 - (1) 半导体材料行业发展特点
 - (2) 半导体材料行业市场规模
 - (3) 半导体材料行业在全球的地位
- 3.2.4 北美半导体材料行业发展分析
 - (1) 半导体材料行业发展特点
 - (2) 半导体材料行业市场规模
 - (3) 半导体材料行业在全球的地位
- 3.3 全球半导体材料代表企业案例分析
 - 3.3.1 日本揖斐电株式会社 (IBIDEN)
 - (1) 企业基本情况
 - (2) 企业经营情况
 - (3) 企业半导体材料业务布局
 - (4) 企业在华投资布局情况
 - 3.3.2 日本信越化学工业株式会社
 - (1) 企业基本情况
 - (2) 企业经营情况
 - (3) 企业半导体材料业务布局
 - (4) 企业在华投资布局情况
 - 3.3.3 日本株式会社SUMCO
 - (1) 企业基本情况
 - (2) 企业经营情况
 - (3) 企业半导体材料业务布局
 - (4) 企业在华投资布局情况
 - 3.3.4 空气化工产品有限公司
 - (1) 企业基本情况
 - (2) 企业经营情况
 - (3) 企业半导体材料业务布局
 - (4) 企业在华投资布局情况
 - 3.3.5 林德集团
 - (1) 企业基本情况
 - (2) 企业经营情况
 - (3) 企业半导体材料业务布局

(4) 企业在华投资布局情况

3.4 全球半导体材料行业发展前景及趋势

3.4.1 全球半导体材料行业发展前景分析

3.4.2 全球半导体材料行业发展趋势分析

第4章 中国半导体材料行业发展现状分析

4.1 中国半导体材料行业发展概述

4.1.1 行业发展历程分析

4.1.2 中国半导体材料行业市场规模分析

4.1.3 中国半导体材料行业在全球的地位分析

4.1.4 中国半导体材料行业企业竞争格局

4.2 中国半导体材料行业进出口分析

4.2.1 中国半导体材料行业进出口市场分析

4.2.2 中国半导体材料行业进口分析

(1) 行业进口总体分析

(2) 行业进口主要产品分析

4.2.3 中国半导体材料行业出口分析

(1) 行业出口总体分析

(2) 行业出口主要产品分析

4.3 中国半导体材料行业波特五力模型分析

4.3.1 现有竞争者之间的竞争

4.3.2 对关键要素的供应商议价能力分析

4.3.3 对消费者议价能力分析

4.3.4 行业潜在进入者分析

4.3.5 替代品风险分析

4.3.6 竞争情况总结

4.4 中国半导体材料行业发展痛点分析

4.4.1 前端晶圆制造材料核心优势不足

4.4.2 半导体材料对外依存度大

4.4.3 半导体材料国产化不足

第5章 中国半导体材料行业细分市场分析

5.1 中国半导体材料工艺及细分市场构成分析

5.1.1 半导体制造工艺

5.1.2 中国半导体材料行业细分市场格局

- (1) 中国半导体材料行业细分市场竞争格局
- (2) 中国晶圆制造材料细分产品规模情况
- (3) 中国封装材料细分产品规模情况
- 5.2 中国半导体材料（前端晶圆制造材料）发展现状及趋势分析
 - 5.2.1 中国半导体硅片发展现状及趋势分析
 - (1) 半导体硅片工艺概述
 - (2) 半导体硅片技术发展分析
 - (3) 半导体硅片发展现状分析
 - (4) 半导体硅片竞争格局
 - (5) 半导体硅片国产化现状
 - (6) 半导体硅片发展趋势分析
 - 5.2.2 中国电子特气发展现状及趋势分析
 - (1) 电子特气工艺概述
 - (2) 电子特气技术发展分析
 - (3) 电子特气发展现状分析
 - (4) 电子特气竞争格局
 - (5) 电子特气国产化现状
 - (6) 电子特气发展趋势分析
 - 5.2.3 中国光掩膜版发展现状及趋势分析
 - (1) 光掩膜版工艺概述
 - (2) 光掩膜版技术发展分析
 - (3) 光掩膜版发展现状分析
 - (4) 光掩膜版竞争格局
 - (5) 光掩膜版国产化现状
 - (6) 光掩膜版发展趋势分析
 - 5.2.4 中国光刻胶及配套材料发展现状及趋势分析
 - (1) 光刻胶及配套材料工艺概述
 - (2) 光刻胶及配套材料技术发展分析
 - (3) 光刻胶及配套材料发展现状分析
 - (4) 光刻胶及配套材料竞争格局
 - (5) 光刻胶及配套材料国产化现状
 - (6) 光刻胶及配套材料发展趋势分析
 - 5.2.5 中国抛光材料发展现状及趋势分析
 - (1) 抛光材料工艺概述
 - (2) 抛光材料技术发展分析

- (3) 抛光材料发展现状分析
- (4) 抛光材料竞争格局
- (5) 抛光材料国产化现状
- (6) 抛光材料发展趋势分析
- 5.2.6 中国湿电子化学品发展现状及趋势分析
 - (1) 湿电子化学品工艺概述
 - (2) 湿电子化学品技术发展分析
 - (3) 湿电子化学品发展现状分析
 - (4) 湿电子化学品竞争格局
 - (5) 湿电子化学品国产化现状
 - (6) 湿电子化学品发展趋势分析
- 5.2.7 中国靶材发展现状及趋势分析
 - (1) 靶材工艺概述
 - (2) 靶材技术发展分析
 - (3) 靶材发展现状分析
 - (4) 靶材竞争格局
 - (5) 靶材国产化现状
 - (6) 靶材发展趋势分析
- 5.3 中国半导体材料（后端封装材料）发展现状及趋势分析
 - 5.3.1 中国封装基板发展现状及趋势分析
 - (1) 封装基板工艺概述
 - (2) 封装基板技术发展分析
 - (3) 封装基板发展现状分析
 - (4) 封装基板竞争格局
 - (5) 封装基板国产化现状
 - (6) 封装基板发展趋势分析
 - 5.3.2 中国引线框架发展现状及趋势分析
 - (1) 引线框架工艺概述
 - (2) 引线框架技术发展分析
 - (3) 引线框架发展现状分析
 - (4) 引线框架竞争格局
 - (5) 引线框架国产化现状
 - (6) 引线框架发展趋势分析
 - 5.3.3 中国键合线发展现状及趋势分析
 - (1) 键合线工艺概述

- (2) 键合线技术发展分析
- (3) 键合线市场规模分析
- (4) 键合线竞争格局
- (5) 键合线国产化现状
- (6) 键合线发展趋势分析

5.3.4 中国塑封料发展现状及趋势分析

- (1) 塑封料工艺概述
- (2) 塑封料技术发展分析
- (3) 塑封料市场规模分析
- (4) 塑封料竞争格局
- (5) 塑封料国产化现状
- (6) 塑封料发展趋势分析

5.3.5 中国陶瓷封装材料发展现状及趋势分析

- (1) 陶瓷封装材料工艺概述
- (2) 陶瓷封装材料技术发展分析
- (3) 陶瓷封装材料市场规模分析
- (4) 陶瓷封装材料竞争格局
- (5) 陶瓷封装材料国产化现状
- (6) 陶瓷封装材料发展趋势分析

第6章 中国半导体材料行业领先企业生产经营分析

6.1 半导体材料行业代表企业概况

6.2 半导体材料行业代表性企业案例分析

6.2.1 天津中环半导体股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业经营状况
- (3) 企业盈利能力
- (4) 企业市场战略

6.2.2 上海硅产业集团股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 企业经营状况
- (3) 企业盈利能力
- (4) 企业市场战略

6.2.3 浙江金瑞泓科技股份有限公司

- (1) 企业概况

(2) 企业经营状况

(3) 企业盈利能力

(4) 企业市场战略

6.2.4 有研新材料股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 企业经营状况

(3) 企业盈利能力

(4) 企业市场战略

6.2.5 福建阿石创新材料股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 企业经营状况

(3) 企业盈利能力

(4) 企业市场战略

6.2.6 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 企业经营状况

(3) 企业盈利能力

(4) 企业市场战略

6.2.7 湖北鼎龙控股股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 企业经营状况

(3) 企业盈利能力

(4) 企业市场战略

6.2.8 安集微电子科技（上海）股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 企业经营状况

(3) 企业盈利能力

(4) 企业市场战略

6.2.9 江苏雅克科技股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 企业经营状况

(3) 企业盈利能力

(4) 企业市场战略

6.2.10 苏州金宏气体股份有限公司

(1) 企业概况

- (2) 企业经营状况
- (3) 企业盈利能力
- (4) 企业市场战略

第7章 中国半导体材料行业市场及投资策略建议

7.1 中国半导体材料行业市场

7.1.1 半导体材料行业生命周期判断

7.1.2 半导体材料行业发展潜力评估

7.1.3 半导体材料行业前景预测

7.2 中国半导体材料行业投资特性

7.2.1 行业进入壁垒分析

7.2.2 行业退出壁垒分析

7.2.3 行业投资风险预警

7.3 中国半导体材料行业投资价值与投资机会

7.3.1 行业投资价值评估

7.3.2 行业投资机会分析

7.4 中国半导体材料行业投资策略与可持续发展建议

7.4.1 行业投资策略与建议

7.4.2 行业可持续发展建议

图表目录

图表1：半导体前端制造材料分类及主要用途

图表2：半导体后端封装材料分类及主要用途

图表3：半导体材料行业所属的国民经济分类

图表4：报告的研究方法及数据来源说明

图表5：中国半导体材料行业监管体制

图表6：截止到2023年中国半导体材料标准

图表7：截至2023年半导体材料行业发展主要政策汇总

图表8：《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》政策解读

图表9：《国家集成电路产业发展推进纲要》政策解读与规划

图表10：中国主要省市半导体产业发展规划

图表11：“十四五”期间地方层面半导体产业规划

图表12：2019-2023年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）

图表13：2019-2023年全国固定资产投资（不含农户）增长速度（单位：万亿元，%）

图表14：2019-2023年中国同比工业增加值增速（单位：%）

图表15：2023年中国GDP的各机构预测（单位：%）

图表16：2023年中国综合展望

图表17：中国大基金一期半导体材料投资标的（单位：亿元，%）

图表18：中国大基金二期半导体材料投资标的（单位：亿元，亿美元，%）

图表19：2019-2023年中国半导体行业并购交易案汇总（单位：百万美元，亿人民币）

图表20：2019-2023年中国半导体材料行业投融资事件情况分析（单位：件，亿元）

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1171445.html>